

平成 19 年 5 月 16 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ジ ー ダ ッ ト  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 石 橋 眞 一  
(コード番号：3841)  
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 経 営 企 画 部 長 増 山 雅 美  
電 話 番 号 03-5847-0312 (代表)

## 米国 Takumi 社との業務および資本提携に関するお知らせ

株式会社ジーダット(以下ジーダット)は、Takumi Technology Corporation(本社:米国、以下 Takumi 社)との間で業務および資本提携の契約を行う事に合意し、本日開催の当社取締役会において決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 提携の目的

ジーダットは、昨年参入を開始しましたDFM分野への製品ラインアップ強化のため、今回の業務提携を行います。これまでジーダットは、**CMP-Designer**(自社開発のCMPシミュレータ)の他、**HOTSCOPE**(大日本印刷株式会社製DFMビューワ)、**EYES/PEYE**(英国 Predictions Software Ltd.社製歩留まり解析ツール)、及び**InShape/OutPerform**(米国 Clear Shape Technologies 社製ホットスポット解析と物理的・電氣的DFMソリューション提供のためのEDAツール)等の製品販売を行って参りました。今回の Takumi 社との提携により、さらに2つの機能(ホットスポットの自動解消機能、及びマスク欠陥解析機能)を拡充して、DFM分野に於ける強力なトータルソリューションを実現できます。

#### 2. 提携の概要

Takumi 社は、LSI 製造に於ける最先端の歩留まり解析技術、及び歩留まり向上のための高度なレイアウト最適化技術を保有しており、既に数多くの大手半導体メーカーで実績がある、極めて優れた製品を開発・販売しています。今回の業務提携は、それら先進の Takumi 社製品をジーダットが日本国内で販売・サポートするための代理店契約です。

さらにジーダットは、この業務提携を期に Takumi 社に \$ 1,000,000(約 1 億 2 千万円)の株式投資を行ない、両社の将来的な技術交流を視野に入れた強固な関係構築を目指します。

#### 3. 製品の概要

Takumi 社の製品は下記の3つにより構成されています。

- **Takumi Enhance** : ライブラリを対象としたホットスポット自動解消ツール
- **Takumi HSF (Hotspot Fix)** : 大規模フルチップを対象としたホットスポット自動解消ツール
- **Takumi Defect Analyzer** : マスク欠陥解析ツール

**Takumi Enhance** についてはLSIプロセス開発及び量産化技術を有している大手IDM基盤開発部門を、また **Takumi HSF** はこれら大手IDM基盤開発部門に加えて、ライブラリ開発力や特殊なIP設計力を有するファブレスメーカーまたは大手IDM内のLSI製品設計部門を、そして **Takumi Defect Analyzer** についてはマスク製造企業を、それぞれの製品の主要なお客様ととらえ、販売を行っていく予定です。お客様は、これら3製品を用いたソリューションを構築することにより

- ・ホットスポットの自動解消による、歩留まり向上と早期量産化
- ・マスク製造手戻りの削減による、開発期間とコストの大幅削減

を達成することができます。

ジーダットはこれら3製品で今後3年間に総額5～10億円の売上を見込んでおります。

#### 4. Takumi 社の概要

- (1) 商号 Takumi Technology Corporation
- (2) 所在地 150 Mathilda Place, Suite 288 Sunnyvale, CA 94086
- (3) 代表者 Akifumi Goto, CEO & President
- (4) 設立 2003年10月
- (5) 資本金 \$14.5M
- (6) 従業員数 約50名
- (7) 売上高 約\$5M (2006年11月期実績)  
約\$8M (2007年11月期計画)
- (8) 業務内容 半導体向けEDA分野のDFMにフォーカスした製品の開発、販売、サポート
- (9) 当社との関係 これまで、資本関係、人的関係、取引関係はございません。

#### 5. 日程

- |            |        |
|------------|--------|
| 平成19年5月16日 | 取締役会決議 |
| 平成19年5月16日 | 提携開始   |

#### 6. 今後の業績に与える影響

現時点において、平成20年3月期の当社の業績に与える影響は軽微であります。

以上

#### 【用語説明】

- ・DFM : Design For Manufacturability、半導体製造の事を考慮した設計手法/設計ツール
- ・CMP : Chemical Mechanical Polishing、半導体の製造プロセスの1つ、化学的機械的研磨技術
- ・EDA : Electronic Design Automation、プリント基板や電子部品向けの電子設計用CAD
- ・ホットスポット : 半導体製造時に欠陥となる可能性が高い危険箇所
- ・LSI : Large Scale Integrated Circuit、大規模IC
- ・IDM : Integrated Device Manufacturer、設計から製造まで行う垂直統合型デバイスメーカー
- ・IP : Intellectual Property、半導体の回路やレイアウト等の設計資産/ライブラリ